

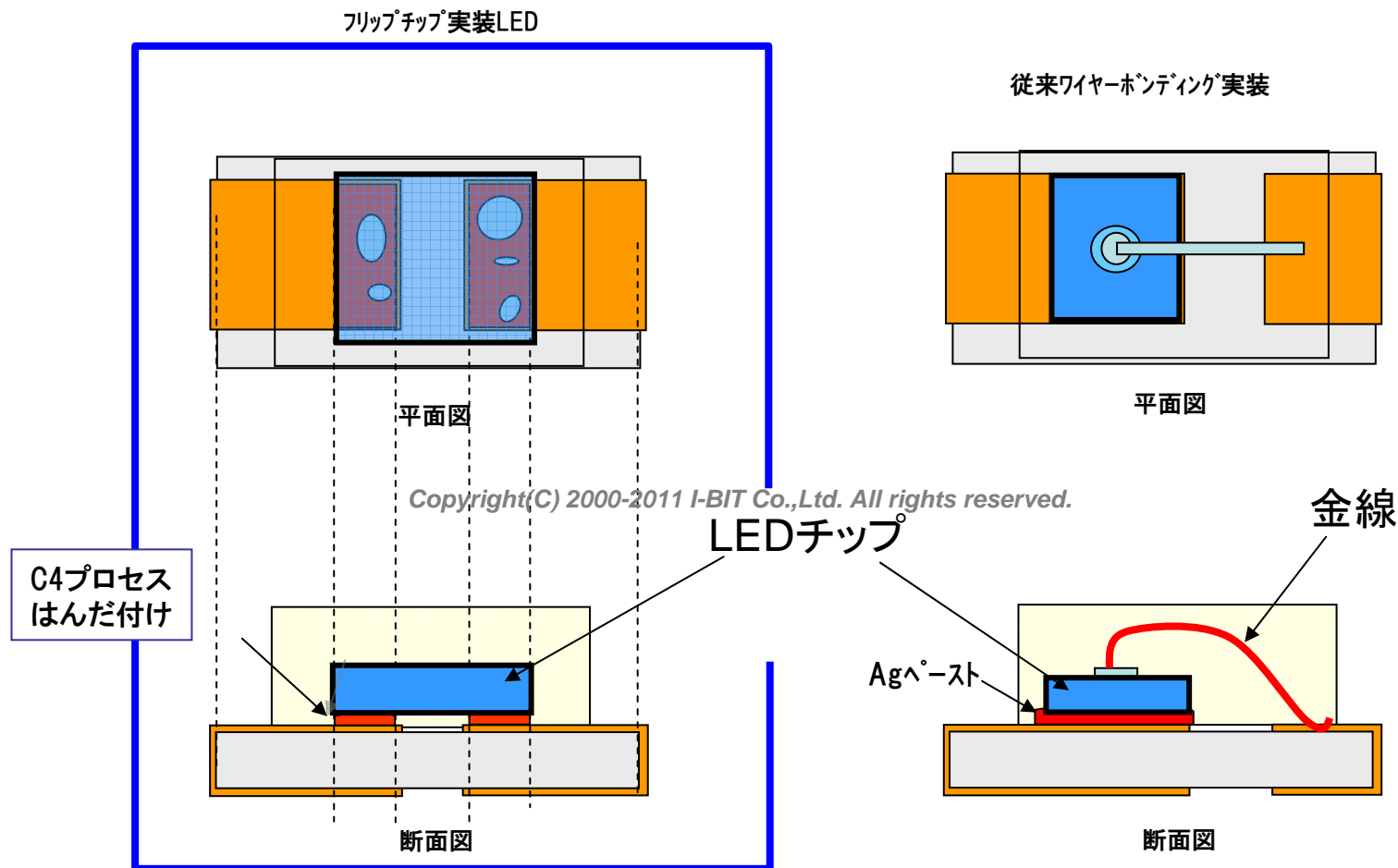
# フリップチップ実装対応LEDのX線検査装置



C4プロセスのチップはんだ量、ボイド率などを自動検査、不良箇所にはNGマーキング



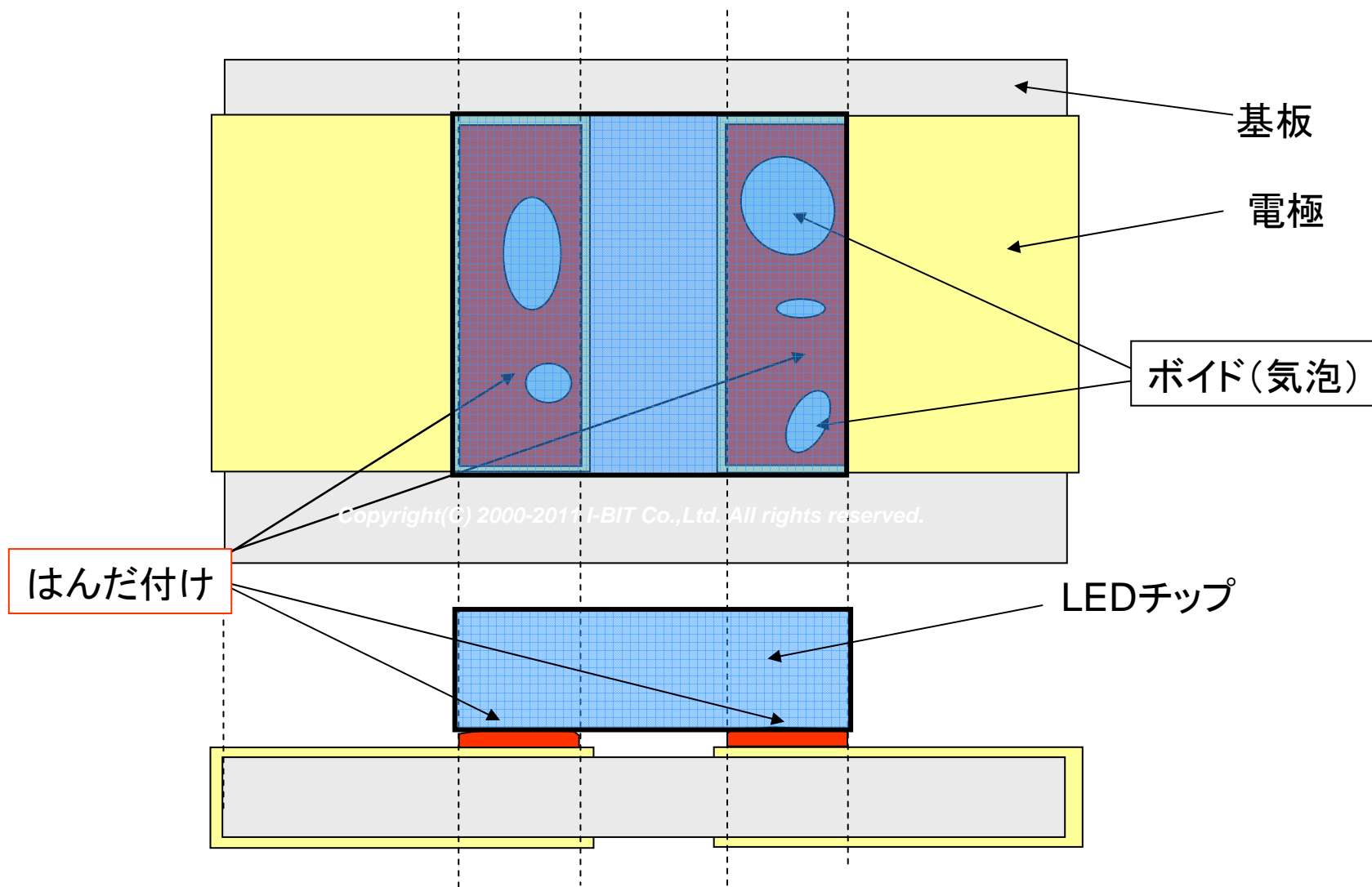
# フリップチップ実装・LEDチップ



C4プロセス(はんだ付け)の採用によりコストダウンが図られる

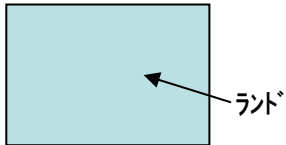
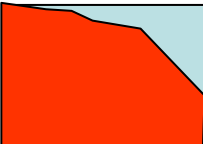
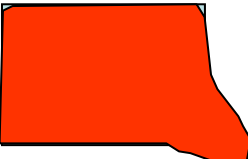
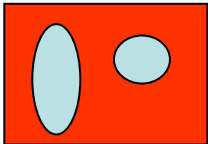

# C4プロセス下面電極のはんだ付け問題点

2011/4/27



下面のはんだ部にボイドが発生しても検査できない

# X線による検査項目

検査内容	はんだ形状	判定値	検査履歴保存
はんだ無し		面積比率=0%	検査画像 検査結果LOG
はんだ過少		面積比率 =指定値(%)以下	検査画像 検査結果LOG
はんだ流れ		外周はみだし量	検査画像 検査結果LOG
ボイド(気泡)		気泡部の面積(%) が指定値以上	検査画像 検査結果LOG
LEDチップなし		はんだ形状によって 中央に丸く集まってし まった場合	検査画像 検査結果LOG

Copyright(C) 2000-2011 I-BIT Co.,Ltd. All rights reserved.

# Question ?

本資料の著作権はI-BITに帰属します。  
全部および一部の複写、複製による配布はご遠慮ください。

製品、内容についてのご質問がありましたら  
下記まで連絡ください。

株式会社 アイビット

〒213-0012

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

かながわサイエンスパーク(KSP)東棟6F

URL: [www.i-bit.co.jp](http://www.i-bit.co.jp)

TEL 044-829-0067

FAX 044-829-1055